

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年8月15日(15.08.2024)



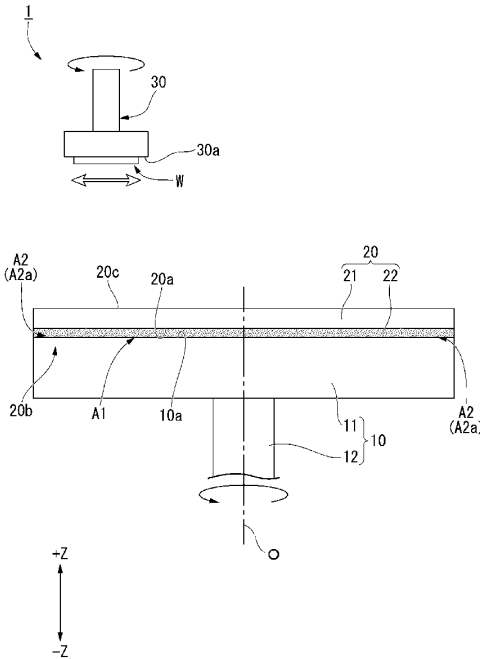
(10) 国際公開番号

WO 2024/166892 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/12 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
B24B 37/20 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/003814
- (22) 国際出願日: 2024年2月6日(06.02.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-016711 2023年2月7日(07.02.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 寺田 哲也 (TERADA Tetsuya);
〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号
株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 及川 周, 外 (OIKAWA Shu et al.);
〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: SUBSTRATE POLISHING DEVICE AND POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 基板研磨装置および研磨パッド



(57) Abstract: A substrate polishing device according to the present invention comprises: a turntable that has a first adhesion surface; and a polishing pad that has a second adhesion surface that is fixed by adhesion to the first adhesion surface. An adhesion area and a first separation assistance area are provided between the first adhesion surface and the second adhesion surface. The first adhesion surface and the second adhesion surface are adhered at the adhesion area. The adhesive force that works between the first adhesion surface and the second adhesion surface at the first separation assistance area is less than the adhesive force that works between the first adhesion surface and the second adhesion surface at the adhesion area. The first separation assistance area is positioned at an outer circumferential part of the polishing pad.

(57) 要約: 基板研磨装置は、第1接着面を有するターンテーブルと、前記第1接着面に対して接着固定される第2接着面を有する研磨パッドと、を備える。前記第1接着面と前記第2接着面との間には、接着領域および第1剥離補助領域が設けられている。前記接着領域においては、前記第1接着面と前記第2接着面とが接着されている。前記第1剥離補助領域において前記第1接着面と前記第2接着面との間に働く接着力は、前記接着領域において前記第1接着面と前記第2接着面との間に働く接着力よりも小さい。前記第1剥離補助領域は、前記研磨パッドの外周部に位置する。

[続葉有]

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))